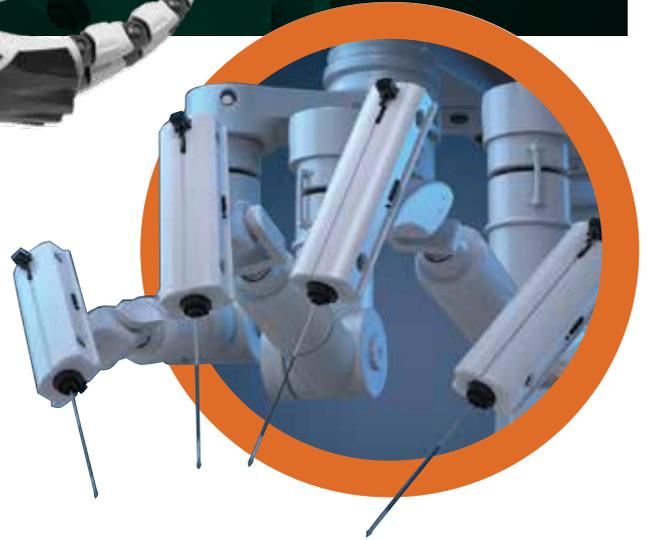


Advancing Medical Technologies



Optics

金スズ半田ワイヤや棒半田



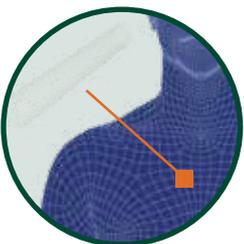
Guide Wire

ニチノールやSUS接合用フラックス



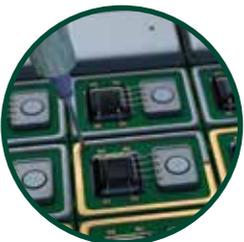
Circuit Boards

半田ペースト



Implantable Feedthroughs

金スズプリフォーム



MEMS Sensors

ダイアタッチ用半田ペースト

Contact our engineers: asiapac@indium.com

Learn more: www.indium.com/medical

From One Engineer To Another[®]

©2020 Indium Corporation

Form No. 99708 (J A4) R0



Advancing Medical Technologies

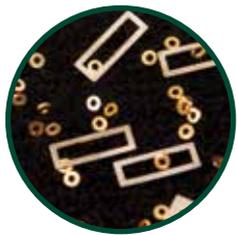


Wearable Devices

- フレキシブル基板の組立
- MEMSのリッド封止
- 高機能デバイスの小型化

PRODUCTS:

- 低温はんだ
- 超低残渣無洗浄フラックス
- ファインピッチ用半田ペースト、フラックス

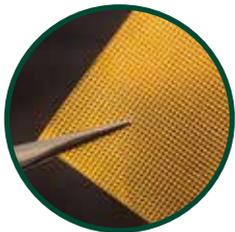


Implantable Devices

- ハーメチックシール
- 高信頼性PCBアセンブリ
- ニチノールの接合

PRODUCTS:

- 金系半田
- 低ボイド用フラックス
- 高活性フラックス



Industrial Devices

- 極低温用シーリング
- 熱拡散
- RF接合

PRODUCTS:

- インジウム系半田ワイヤやプリフォーム
- TIM材料
- 半田プリフォーム



Contact our engineers: asiapac@indium.com

Learn more: www.indium.com/medical

From One Engineer To Another®

©2020 Indium Corporation

Form No. 99708 (J A4) R0

